News Release

GLASS FOR FUTURE
日本電気硝子

2015 年 12 月 9 日
日本電気硝子株式会社

様々な熱膨張係数に対応する半導体用サポートガラスの開発

日本電気硝子株式会社（本社：滋賀県大津市 社長：松本元春）は、様々な熱膨張係数を有し、優れた平坦性を兼ね備えた半導体用サポートガラスを開発し、サンプル出荷を開始しました。12 月 16 日から開催される「SEMICON Japan 2015」(於：東京ビッグサイト)に出展します。

次世代半導体パッケージ技術として期待される FOWLP(Fan Out Wafer Level Package)（※１）のように、半導体と再配線層や樹脂など、熱膨張係数の異なる材料を同一基板上で組み合わせる工程では、熱膨張の違いによる反りを防ぐため、その組み合わせに適した熱膨張係数をもつ基板が必要となります。

今回開発した半導体用サポートガラスは、こうしたニーズに対応する基板として、熱膨張係数がシリコン基板と同程度の 3.3ppm/℃から、樹脂比率の高いパッケージに対応する 10ppm/℃超のバリエーションを取り揃えました。半導体パッケージの設計材料に合わせて最適なガラスを選択することができます。

2016 年第 1 四半期から FOWLP 用途での量産販売を開始し、2016 年度は１０億円の売上を見込んでいます。さらには、家電分野や産業機器分野で使用が拡大しているパワーデバイス（※2）などの半導体関連製品の製造工程用サポートガラスとしても用途開発を進め、2018 年度には年間３０億円の売上を目指します。

※１　FOWLP：　チップ面積を超える広い領域に再配線層を形成するパッケージ
※２　パワーデバイス：　電力機器向けの半導体素子

（製品概要）

- ●製品寸法：　直径 300mm×　厚さ 0.55～1.00mm
- ●表面平坦度：　TTV（面内肉厚偏差）2μm 以内
- ●熱膨張係数：　3.3～11.0ppm/℃(20～260℃)
- ●その他特性：　透明で光を透過するため、UV 硬化樹脂などの使用にも対応
- ●量産販売時期：　2016 年第 1 四半期(予定)

＊上記以外の仕様のものを希望される場合はご相談ください。

（製品写真）



日本電気硝子株式会社　〒520-8639 滋賀県大津市晴嵐二丁目 7 番 1 号
《リリース内容に関するお問い合せ》
総務部 広報担当　　電話：077-537-1702（ダイヤルイン）
《製品に関するお問い合せ》
電子部品事業本部営業部（大津）　電話：077-537-8767（ダイヤルイン）